

環境貢献製品のGHG貢献量の算定事例

●スマートフォンカメラ向けホールIC (光学式手振れ補正カメラモジュール向け)

**OIS専用プロセッサの搭載を不要化し、
プロセッサ搭載分の基板面積を削減**



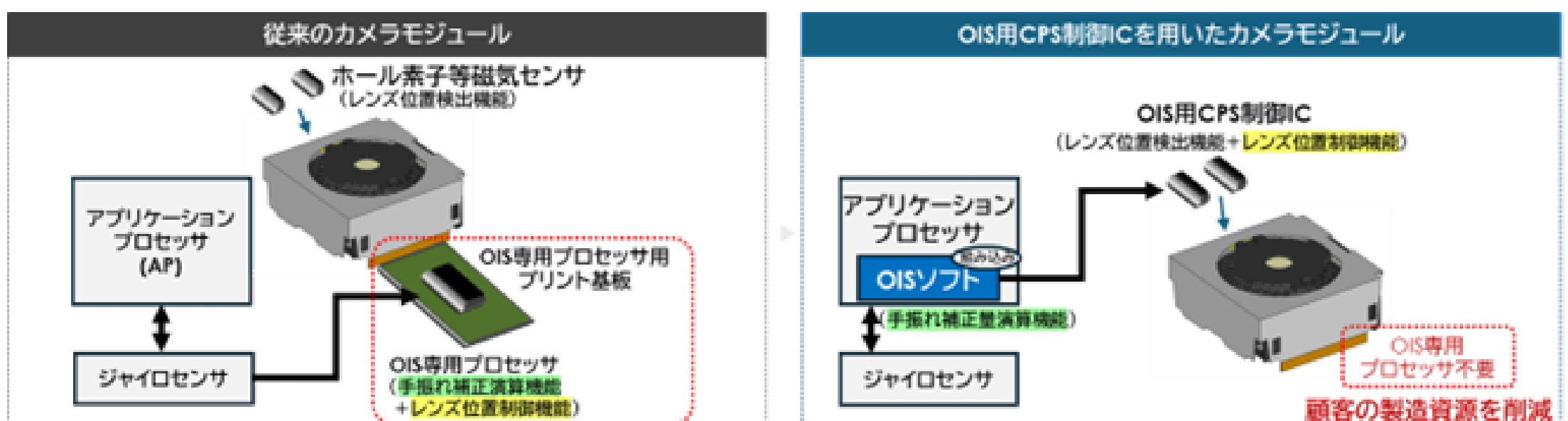
【製品概要】

従来はホール素子等磁気センサ、OIS専用プロセッサを搭載したカメラモジュールが使用されていた。本製品(ホールIC)とアプリケーションプロセッサへのOISソフトウェア提供により、OIS専用プロセッサを不要化した。プロセッサ搭載分の基板面積削減により、顧客の製造段階におけるGHG排出量の削減に貢献します。

【貢献段階(ライフサイクルステージ)】



【構成比較イメージ】



【計算方法・算定結果】

$$\begin{aligned} & \text{削減量 (1台あたり)} \\ & \{ + \text{ホール素子等磁気センサCFP} \\ & + \text{OIS専用プロセッサCFP} \\ & + \text{プロセッサ搭載分の基板面積} \\ & - \text{本製品 (ホールIC) CFP} \} \\ & \times \text{販売数量} = \text{GHG 削減貢献量} \end{aligned}$$